



中華民國專利證書

新型第 M593659 號

新型名稱：直接導出電子元件熱能的封裝結構

專利權人：晶泰國際科技股份有限公司

新型創作人：黃峰潭

專利權期間：自2020年4月11日至2029年9月5日止

上開新型業依專利法規定通過形式審查取得專利權
行使專利權如未提示新型專利技術報告不得進行警告

經濟部智慧財產局 局長

洪淑敏

中華民國 109 年 4 月 11 日

